



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月6日

東

上場会社名 日本電子材料株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6855 URL <https://www.jem-net.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 坂田 輝久
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 管理部門統括部長 (氏名) 石本 浩久 TEL 06-6482-2007
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績 (2025年4月1日～2025年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
2026年3月期第3四半期	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	20,675	40.3	5,028	77.5	4,893	66.5	3,468	69.0
	14,738	22.7	2,832	—	2,938	—	2,052	—

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 3,307百万円(57.7%) 2025年3月期第3四半期 2,097百万円(443.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後	
		1株当たり	四半期純利益
2026年3月期第3四半期	円 銭	円 銭	
2025年3月期第3四半期	274.34	—	—
	162.52	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2026年3月期第3四半期	百万円	百万円	%
2025年3月期	41,572	30,381	73.1
	39,859	27,914	70.0

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 30,381百万円 2025年3月期 27,914百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2025年3月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	30.00	—	40.00	70.00
2026年3月期(予想)	—	30.00	—	50.00	80.00

(注1) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

(注2) 2025年3月期期末配当金の内訳 普通配当 35円00銭 記念配当 5円00銭

3. 2026年3月期の連結業績予想 (2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
通期	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 — 社 (社名) 、除外 — 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年3月期 3 Q	12,666,510株	2025年3月期	12,647,416株
② 期末自己株式数	2026年3月期 3 Q	16,034株	2025年3月期	15,900株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2026年3月期 3 Q	12,642,906株	2025年3月期 3 Q	12,630,538株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 2 ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 3
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 7
(セグメント情報等の注記)	P. 7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 7
(継続企業の前提に関する注記)	P. 7
(重要な後発事象)	P. 8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	P. 8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられたものの、雇用・所得環境の改善と各種政策の効果により、緩やかな回復傾向が続きました。しかしながら、物価上昇、米国の通商政策をめぐる動向、金融資本市場の変動等により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、データセンター向けや生成AIの画像処理半導体や広帯域メモリー（HBM）等の先端半導体の旺盛な需要が継続する一方で、自動車向け等の回復は遅れる状況で推移いたしました。

このような事業環境の中、当第3四半期連結累計期間においては、メモリー向けプローブカードの拡販が大きく進んだことにより、売上高につきましては、前第3四半期連結累計期間を大きく上回る結果となりました。利益面につきましても、売上高の増加に加えて、国内工場の高い稼働率により、前第3四半期連結累計期間を大きく上回る結果となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は20,675百万円（前年同四半期比40.3%増）、営業利益は5,028百万円（前年同四半期比77.5%増）、経常利益は4,893百万円（前年同四半期比66.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,468百万円（前年同四半期比69.0%増）となりました。

報告セグメント別の業績は次のとおりです。

a. 半導体検査用部品関連事業

半導体検査用部品関連事業につきましては、非メモリー向けプローブカードの需要は低調に推移しました。一方で、メモリー向けプローブカードについては、国内外の先端半導体向けでの需要拡大に加え、回復しつつある主要顧客のニーズにも応えるべく、増産に努めました。さらに、一昨年竣工した熊本第4工場の本格稼働も生産能力の向上に寄与しました。これにより、全体の売上高は前第3四半期連結累計期間を大きく上回る結果となりました。利益面につきましても、将来的な生産能力と製品力の強化を目的とした先行投資に伴うコスト増加があったものの、売上高の増加に加えて、国内工場の高い稼働率により、前第3四半期連結累計期間を大きく上回る結果となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は20,507百万円（前年同四半期比40.7%増）、セグメント利益は6,367百万円（前年同四半期比69.5%増）となりました。

b. 電子管部品関連事業

電子管部品関連事業の売上高は167百万円（前年同四半期比0.1%増）、セグメント利益は6百万円（前年同四半期比19.0%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,712百万円増加し、41,572百万円となりました。

これは主として、電子記録債権が525百万円減少いたしましたが、現金及び預金が1,096百万円、仕掛品が178百万円、原材料及び貯蔵品が243百万円、建設仮勘定が763百万円増加したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ753百万円減少し、11,191百万円となりました。

これは主として、電子記録債務が253百万円、設備電子記録債務が152百万円増加いたしましたが、買掛金が591百万円、未払法人税等が130百万円、賞与引当金が231百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,466百万円増加し、30,381百万円となりました。

これは主として、為替換算調整勘定が163百万円減少いたしましたが、利益剰余金が2,583百万円増加したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日（2026年2月6日）「2026年3月期通期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」並びに「新工場建設に関するお知らせ」を公表いたしましたのでご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,148	13,244
受取手形	0	—
電子記録債権	1,166	641
売掛金	10,656	10,793
有価証券	40	39
製品	619	661
仕掛品	1,605	1,783
原材料及び貯蔵品	1,939	2,183
その他	321	424
貸倒引当金	△33	△29
流動資産合計	28,463	29,742
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,429	5,233
機械装置及び運搬具（純額）	2,875	2,942
建設仮勘定	442	1,205
その他（純額）	1,890	1,831
有形固定資産合計	10,638	11,214
無形固定資産		
無形固定資産	259	281
投資その他の資産		
その他	499	335
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	498	334
固定資産合計		
固定資産合計	11,395	11,829
資産合計	39,859	41,572
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	544	798
買掛金	1,601	1,009
設備電子記録債務	40	192
1年内償還予定の社債	100	100
1年内返済予定の長期借入金	1,231	1,249
未払法人税等	971	841
賞与引当金	623	392
その他	1,675	1,468
流動負債合計	6,789	6,053
固定負債		
社債	800	750
長期借入金	3,749	3,846
その他	606	541
固定負債合計	5,155	5,137
負債合計	11,944	11,191

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,074	3,095
資本剰余金	3,293	3,315
利益剰余金	20,450	23,034
自己株式	△16	△16
株主資本合計	26,801	29,428
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8	10
為替換算調整勘定	1,104	941
その他の包括利益累計額合計	1,112	952
純資産合計	27,914	30,381
負債純資産合計	39,859	41,572

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	14,738	20,675
売上原価	8,600	11,651
売上総利益	6,137	9,023
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	794	942
退職給付費用	12	14
研究開発費	1,101	1,225
その他	1,396	1,813
販売費及び一般管理費合計	3,305	3,995
営業利益	2,832	5,028
営業外収益		
受取利息	26	22
受取配当金	10	2
為替差益	81	—
その他	21	17
営業外収益合計	140	43
営業外費用		
支払利息	21	40
社債利息	5	5
為替差損	—	116
固定資産廃棄損	5	14
その他	0	0
営業外費用合計	34	177
経常利益	2,938	4,893
特別利益		
補助金収入	40	122
特別利益合計	40	122
税金等調整前四半期純利益	2,978	5,015
法人税、住民税及び事業税	894	1,372
法人税等調整額	31	174
法人税等合計	926	1,547
四半期純利益	2,052	3,468
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,052	3,468

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	2,052	3,468
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1	2
為替換算調整勘定	43	△163
その他の包括利益合計	44	△160
四半期包括利益	2,097	3,307
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,097	3,307

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	14,570	167	14,738	—	14,738
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	14,570	167	14,738	—	14,738
セグメント利益	3,755	8	3,763	△ 931	2,832

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	20,507	167	20,675	—	20,675
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	20,507	167	20,675	—	20,675
セグメント利益	6,367	6	6,374	△ 1,345	5,028

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

当社は、2026年2月6日開催の取締役会にて、新工場を建設することを下記のとおり決議いたしました。

1. 建設の目的

今後も拡大が見込まれるMタイププローブカード（MEMS技術を用いたプローブカード）の生産体制及び生産効率の強化、並びに次世代半導体向けプローブカードの開発推進により、顧客需要への対応力を向上させるため、兵庫県尼崎市において新工場を建設することを下記のとおり決議いたしました。

なお、Mタイププローブカードの生産において、既存の本社工場はプローブの生産、三田工場は配線基板の生産、熊本事業所はアッセンブリをそれぞれ担っているところ、当該新工場はMタイプ用プローブ等の開発・生産の強化を図るものであります。

2. 建設計画の概要

(1) 名称	本社第2工場（仮称）
(2) 建設予定地	兵庫県尼崎市
(3) 投資内容	土地、建物及びプローブカードの製造・研究開発設備等
(4) 建設着工予定期間	2026年4月
(5) 竣工予定期間	2028年8月
(6) 建築面積	約3,000m ²
(7) 延床面積	約8,000m ²
(8) 投資予定期額	約125億円
(9) 資金計画	自己資金及び借入金

3. 業績への影響

本件が2026年3月期における業績に与える影響はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	853百万円

1,052百万円